

令和5年度 京都実装技術研究会オープニングセミナーの開催について

令和5年4月18日
京都府中小企業技術センター
担当: 応用技術課
電話: 075-315-8634

京都府中小企業技術センターでは、電子機器の生産に深く関わる技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマとして、その解決を目的とした「京都実装技術研究会」を設置しています。

この度令和5年度の会員を募集するため、オープニングセミナーを以下のとおり開催します。

- 1 日 時 令和5年5月30日(火) 13:30~17:00
- 2 開催方式 会場参加/Web(zoom) 併用 (講師は会場での講演です)
- 3 会 場 京都府産業支援センター 5階 研修室
(京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内)
- 4 内 容

「世界半導体産業・技術の流れと日本の立ち位置」

講師 ^{つだ けんじ}津田 建二 氏/国際技術ジャーナリスト

・News&Chips 編集長・セミコンポータル編集長

世界の半導体は今、どのような方向に向いているのか、それに対して日本の立ち位置はどうなっているか。半導体をけん引するドライバは電機からITへ変化し、世界の半導体はデジタル化へまっしぐらに進んでいる。次のトレンドであるIoT、5G、AI、そしてメタバース、さらに生成AIの時代を迎え、半導体はどう対応するのか。日本復活に向けたヒントは世界の成功企業にある。パワー半導体は世界と対抗できるのか。世界のヒントと今後の半導体のあるべき姿を描く。

- 5 定 員 会場: 40名 Web: 40名
- 6 参加費 無 料
- 7 申込締切 令和5年5月26日(金) まで
- 8 申 込 先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp
※ホームページ(<https://www.kptc.jp/>)からも申込みができます。

